联络人
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204
ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2019 年第三季自结财务报告

2019 年 10 月 25 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(25)日公告 2019 年第三季自结财务报告。

2019 年第三季财务概况

- 本季合并营收新台币 64.04 亿元，为历史新高，较前季增加 44%，较去年同期增加 58%
- 本季合并毛利率为 42.1%，为历史新高，较前季增加 8.1 个百分点；
  本季营业净利率 31.4%，为历史次高，较前季增加 10.8 个百分点
- 本季营业净利为新台币 20.12 亿元，较前季增加 119%，较去年同期增加 369%
- 本季税后净利为新台币 16.37 亿元，为历史新高，较前季增加 112%，较去年同期增加 135%；每股盈余为新台币 3.90 元，为历史新高，前季为新台币 1.87 元

2019 年第四季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 第四季营收预计较第三季成长 mid-single digit。
- 第四季毛利率预计约与第三季相当。

免责声明
本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

“首先，我们很高兴看到2019年第三季稳懋营运再度缔造了数个历史高峰。第三季营收为新台币64亿元，季成长率及年成长率分别为+44%及+58%，这是继2017年第四季之后稳懋营收再次达到另一个历史高点，累计前三季营收为新台币144.7亿元，年成长率为+11%。稳懋甫于第二季底开出新产能，第三季在强劲的客户需求之下，实时搭上了旺季的列车，在产能利用率攀高的同时，毛利率上升到42.1%的历史新高，营业利益率31.4%达到历史次高水位，净利及EPS也分别创下了新台币16.4亿元及3.9元的单季历史新高。

在第三季手机传统旺季需求带动下，稳懋整体营收从七月开始就明显反应旺季的需求，连续三个月都创单月新高纪录。相对于前一季，第三季举凡应用于手机中的Cellular、Wi-Fi及VCSEL芯片出货都有显著成长，就连季节性不甚明显的基础建设相关需求也都延续上半年的成长动能，有不错的表现，使得目前稳懋产能再度面临吃紧状态。为因应明年5G的终端需求，稳懋近期宣布启动新一轮的扩充计划，月产能将从目前的3.6万片扩大到4.1万片，可望于明年第二季开始贡献产能，为旺季需求预做准备。

2019年可以称为5G元年，虽然目前5G网络还不普及，但各国的电信商及手机制造商无不摩拳擦掌，期望取得先机。我们乐见目前稳懋手机PA出货中5G占比已超过一成，并坚信未来几年随着5G通信的逐年普及，将成为稳懋中长期稳定的成长动能。

展望2019年第四季，在客户需求依然强劲之下，我们预计季营收成长率为mid-single digit，毛利率约与第三季相当。同时，2019年稳懋全年营收预估较去年成长超过两成的水平，可望优于台湾半导体产业成长0.1%及全球半导体产业衰退13.3%的预期。"

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。